

证券代码：688396

证券简称：华润微

公告编号：2025-016

华润微电子有限公司 2024 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.058 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于 30%，主要基于公司所处行业特点、自身经营情况及目前所处的扩充发展阶段。
- 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案基本情况

（一）利润分配方案的具体内容

根据《开曼群岛公司法》和华润微电子有限公司（以下简称“公司”）《经第

九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）的规定，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 44,174.48 万元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，使用公司的收益向投资者分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.58 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 1,327,529,398 股，以此计算合计拟派发现金红利 7,699.67 万元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 10.10%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在可能触及其他风险警示情形的情形。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	76,996,705.08	147,969,201.05	261,774,216.04
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	762,459,866.87	1,479,265,748.53	2,617,267,270.82
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	441,744,784.84		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	486,740,122.17		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 3000 万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,619,664,295.41		

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	486,740,122.17
现金分红比例（%）	30.05
现金分红比例是否低于 30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	3,242,334,548.79
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3 亿元以上	是
最近三个会计年度累计营业收入（元）	30,079,259,216.78
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	10.78
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在 15%以上	否
是否触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

二、2024 年度现金分红比例低于 30%的原因

（一）行业特点及发展情况

公司的主营业务包括功率半导体、智能传感器及智能控制产品的设计、生产及销售，以及提供开放式晶圆制造、封装测试等制造服务，属于半导体行业。

半导体位于电子行业的中游，上游是电子材料和设备。半导体和被动元件以及模组器件通过集成电路板连接，构成了智能手机、电脑等电子产品的核心部件，承担信息的载体和传输功能是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。其发展程度是一个国家科技发展水平的核心指标之一，影响着社会信息化进程。自 2000 年以来，我国政府颁布了一系列政策法规，将集成电路产业确定为战略性新兴产业之一，大力支持集成电路行业的发展。

公司所处的半导体行业属于资本密集型和技术密集型产业，具有下游应用广

泛、生产技术工序多、产品种类多、技术更新换代快、投资高、风险大等特点，决定了公司对于设备和技术的投资较大，从而导致公司的固定资产规模及研发投入较大。

目前公司在部分高端市场的研发实力、工艺积累、产品设计与制造能力及品牌知名度等方面与英飞凌、安森美等国际领先厂商相比存在技术差距。公司在生产经营中相较国际领先厂商在产品性能特性、产品线丰富程度、量产规模、产品下游应用领域的广泛性方面仍处于追赶地位，公司需要长期保持持续研发投入缩小与国际领先厂商的技术差距。

鉴于此，公司为保证整体的市场竞争力，需要在研发、制造等各个环节上持续不断进行资金投入。在设计环节，公司需要持续进行研发投入来跟随市场完成产品的升级换代；在制造环节，产线的建设需要巨额的资本开支及研发投入。如果公司不能持续进行资金投入，则难以确保公司技术的先进性、工艺的领先性和产品的市场竞争力。

（二）公司截至 2024 年末的累计未分配利润情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司财务报表的未分配利润为人民币 44,174.48 万元，合并财务报表的未分配利润为人民币 641,106.41 万元。

（三）公司留存未分配利润的确切用途

结合行业发展情况和公司经营状况，公司正处于加速提升、扩充发展的阶段。充分考虑公司资本结构、发展阶段和未来战略发展等各方面因素，公司留存未分配利润将用于自身业务发展，同时公司保留充足现金储备寻求可能出现的并购机会推动产业并购及整合，以提升公司核心竞争力，进一步提升公司的行业地位。

（四）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供

了便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东会决策提供便利。

（五）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

未来公司将努力做好业务经营，争取更高的盈利水平，争取以现金分红形式回报投资者，严格按照相关法律法规和公司《章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审计合规委员会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第二届董事会审计合规委员会第十六次会议，经全体委员一致同意，审议通过了《2024年度利润分配方案》，并同意将该利润分配预案提交公司董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第二届董事会第二十四次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《2024年度利润分配方案》，并同意将该利润分配预案提交公司2024年年度股东会审议。

四、风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日